

手机保护壳口碑好等离子清洗机

产品名称	手机保护壳口碑好等离子清洗机
公司名称	深圳市诚峰智造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松江路6号满京华科创工坊3号楼1303
联系电话	13632675935 18675544308

产品详情

真空式等离子处理系统CRF-VPO-2L-S

名称 (Name)

真空式等离子处理系统

型号 (Model)

CRF-VPO-2L-S

控制系统 (Control system)

PLC+触摸屏

电源 (Power supply)

380V/AC,50/60Hz, 3kw

中频电源功率 (RF Power)

1000W/40KHz

容量 (Volume)

10L(Optional)

层数 (Electrode of plies)

2(Optional)

腔体规格 (Area)

220(W)*230(D)*230(H)

气体通道 (Gas)

两路工作气体可选 : Ar、N₂、CF₄、O₂

产品概述

设备参数

产品特点

超大处理空间，提升处理产能，采用PLC+触摸屏控制系统，控制设备运行；

可按照客户要求定制设备腔体容量和层数，满足客户的需求；保养维修成本低，便于客户成本控制；

高精度，快响应，良好的操控性和兼容性，完善的功能和的技术支持。

应用范围

真空等离子清洗机适用于印制线路板行业，半导体IC领域、硅胶、塑胶、聚合物领域，汽车电子行业,航空工业等。印制线路板行业：高频板表面活化，多层板表面清洁、去钻污、软板、软硬结合板表面清洁、去钻污，软板补强前活化。半导体IC领域：COB、COG、COF、ACF工艺，用于打线、焊接前的清洗；硅胶、塑胶、聚合物领域硅胶、塑胶、聚合体的表面粗化、刻蚀、活化。

[等离子设备](#)进入人们的视野为我们解决了哪些行业的问题点呢？

等离子设备已经进入人们的视野，并不陌生，广泛应用于金属、微电子、聚合物、生物功能材料、低温灭菌、污染控制等领域，是企业和科研机构等离子体表面处理的理想设备。它的广泛应用是显而易见的。等离子处理机具有稳定性高、均匀性高等优点，独特的处理腔形状和电极结构可以满足不同形状和材料的表面处理要求，包括薄膜、织物、零件、粉末和颗粒。

等离子应用范围有：

印刷品包装行业，覆膜纸盒，紫外线纸盒由于表面光滑，附着力低，经等离子处理后，可以保证像普通纸一样容易印刷。目前已经被大多数印刷包装厂使用。

汽车制造业:EPDM密封条、植绒、涂层预处理、汽车仪表；汽车前灯PP底座，沟槽粘结预处理。

塑胶行业：塑胶瓶在生产线上贴标签前处理湿粘系统，取代热熔和扩散；PP薄膜单面预处理稳定持久，可用于水基分散

粘结剂；塑胶手机外壳和助动车外壳，油漆预处理。

光电制造业:柔性和非柔性印刷电路板触点清洁液晶荧光灯触点清洁；

金属和涂装行业:铝型材进行预处理，取代毛刷和底漆，获得稳定的氧化层；铝箔去除润滑油-无湿化学处理

方法；不锈钢激光焊接前处理。

化学纤维和纺织工业：纤维的预处理速度可达60米/分；玻璃表面与镜面粘接前的平面清洗；

印刷喷墨打印行业:PP材料，HD-PE丝网印刷，聚酰胺(喷墨印刷)预处理，等等。

等离子（电浆）清洗机的主要特点是：

- 1、喷射出的等离子流为中性，不带电，可对聚合物、金属、半导体、橡胶、印刷电路板等材料进行表面处理。
- 2.等离子体处理后表面性能持久稳定，维持时间长；
- 3.干法处理无污染，无废水，符合环保要求；
- 4.可在生产线上在线运行，降低成本。

X-32

半导体封装行业使用等离子体清洗能有效提高粘附焊膏浸润等性能

半导体器件生产中几乎所有工序都有清洗这一步骤，其目的是为了彻底去除器件表面的微粒、有机物和无机物的沾污杂质，以保证产品质量。等离子清洗工艺的独特性，已经逐渐被大家重视起来。

半导体封装行业广泛应用的物理、化学清洗方法大致可分成湿式清洗和干式清洗两类，特别是干式清洗发展非常快，其中等离子体清洗优势明显，有助于提高晶粒与焊盘导电胶的粘附性能、焊膏浸润性能、金属线键合强度、塑封料和金属外壳包覆的可靠性等，在半导体器件、微机电系统、光电元器件等封装领域中推广应用的市场前景广阔。

为保护极易受损的半导体集成电路芯片或电子器件免受周五环境影响，包括物理及化学影响，保证它们的各种正常的功能，利用膜技术及微细连接技术，将半导体元器件及气体构成要素，在框架或基板上布置、固定及链接。引出接线端子，并通过塑性绝缘介质灌封固定，构成实用的整体立体结构的工艺技术。

等离子清洗设备在半导体封装中的应用

(1) 铜引线框架：铜的氧化物与其它一些有机污染物会造成密封模塑与铜引线框架的分层，造成封装后密封性能变差与慢性渗气现象，同时也会影响芯片的粘接和引线键合质量，经过等离子体处理铜引线框架，可去除有机物和氧化层，同时活化和粗化表面，确保打线和封装的可靠性。

(2) 引线键合：引线键合的质量对微电子器件的可靠性有决定性影响，键合区必须无污染物并具有良好的键合特性。污染物的存在，如氧化物、有机污染物等都会严重削弱引线键合的拉力值。等离子体清洗能有效去除键合区的表面污染物并使其粗糙度增加，能明显提高引线的键合拉力，极大的提高封装器件的可靠性。

(3) 倒装芯片封装：随着倒装芯片封装技术的出现，等离子清洗已成为其提高产量的必要条件。对芯片以及封装基板进行等离子体处理，不但能得到超净化的焊接表面，同时还能大大提高焊接表面的活性，这样可以有效防止虚焊和减少空洞，提高填充料的边缘高度和包容性，改善封装的机械强度，降低因不同材料的热膨胀系数而在界面间形成内应的剪切力，提高产品可靠性和寿命。

(4) 陶瓷封装：陶瓷封装中通常使用金属浆料印制线路板作键合区、盖板密封区。在这些材料的表面电镀Ni、Au前采用等离子体清洗，可去除有机物钻污，明显提高镀层质量。